



各種DI露光機に対応  
DI露光対応フレキシブル基板向け液状ソルダーレジスト  
Direct-Imaging Solder Resist for FPC



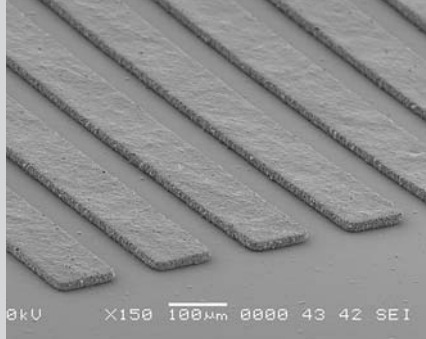
# APB-300-21

特長  
Feature

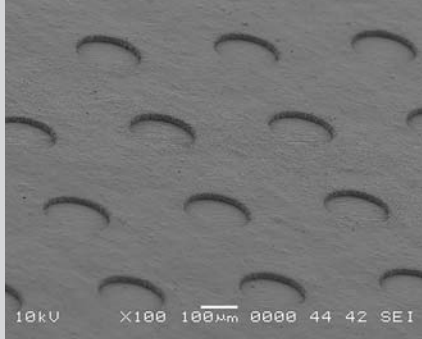
• DI露光機対応インク  
Suitable for Direct-imaging

• 高感度  
High sensitivity

• 高柔軟性  
High flexibility



100µm line on polyimide



200µm via on copper



項目 Items	条件 Test condition	APB-300-21
外観 Appearance	目視/グロス値(60°) Gloss value 60°	黒色マット/10~20 Black Matt/10 ~ 20
露光量 Exposure energy	DI露光機 DI exposure machine	100mJ/cm <sup>2</sup>
屈曲性 Flexibility	はぜ折り(ポリイミド25µm上) Bending 180degree (on Polyimide 25µm)	10回 10 times
塗膜硬度 Film hardness	JIS K5400	H
密着性 Adhesion Cross cut test	ポリイミド上 on polyimide	100/100
	Cu上 on copper	100/100
耐酸性 Acid resistance	10%HCl-15min セロハンテープピーリング 10%HCl-15min tape peeling test	剥離無し No peel-off
耐溶剤性 Solvent resistance	IPA-30min セロハンテープピーリング IPA-30min tape peeling test	剥離無し No peel-off
UL	UL-94	VTM-0